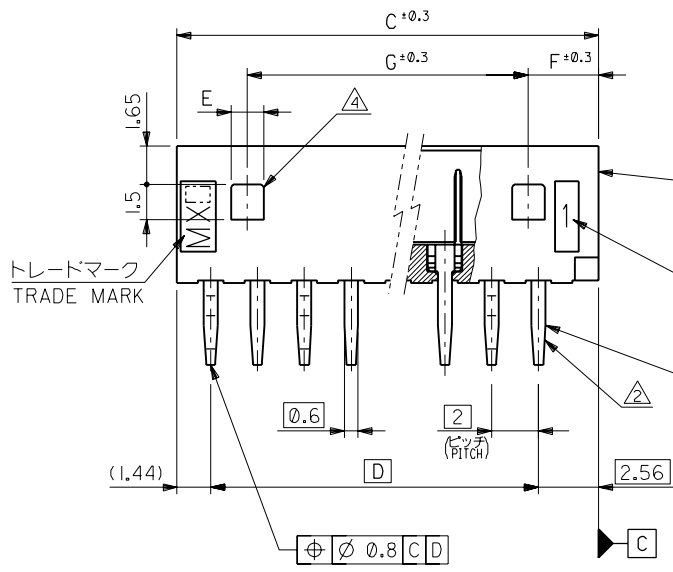
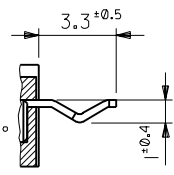


注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51004-\*\*\*00  
MATES WITH : 51004-\*\*\*00
2. 3極品以上のキング加工については、1極おきに2箇所以上を施すこと。  
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER SOLDER TAILS. (FROM THE TRADE MARK SIDE.)
3. \*マークは、色を表わします。  
\* MARK INDICATES DYED COLOR :  
"1"黒 BLACK, "2"赤 RED, "3"黄 YELLOW, "4"青 BLUE
4. ロック用の穴は、2極品及び3極品に1ヶ、4極品以上は2ヶとする。  
LOCKING HOLE : 1 PLACE FOR 2, 3 CKTS. AND MORE THAN 4 CKTS.

2極品のキング形態図  
KINK FORM FOR 2 CKTS.  
両方のテールにキングを施す。  
SOLDER TAIL KINK SHOULD BE ADDED ON BOTH TAILS.



ウエハー WAFER  
(ナイロン66、ガラス入り)  
(NYLON66, GLASS FILLED)  
UL94V-0  
回路番号 CIRCUIT NO.  
ピン PIN  
(リン青銅、錫メッキ)  
(PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED, t=0.32)

26	3	1.4	28	32	31.1	28	53014-151*	15
24	3	1.4	26	30	29.1	26	-141*	14
22	3	1.4	24	28	27.1	24	-131*	13
20	3	1.4	22	26	25.1	22	-121*	12
18	3	1.4	20	24	23.1	20	-111*	11
16	3	1.4	18	22	21.1	18	-101*	10
14	3	1.4	16	20	19.1	16	-091*	9
12	3	1.4	14	18	17.1	14	-081*	8
10	3	1.4	12	16	15.1	12	-071*	7
8	3	1.4	10	14	13.1	10	-061*	6
6	3	1.4	8	12	11.1	8	-051*	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-041*	4
--	4	3.4	4	8	7.1	4	-031*	3
--	3	1.4	2	6	5.1	2	53014-021*	2
G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO. 53014S03	極数 NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL		図中参照 SEE DWG.		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		---		EDP. NO.	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		ENG. NO.	
被覆外径 INS. RANGE		---		SD-53014-***1*	
DRAWN BY M.HENMI '92/5/27		CHK'D BY H.HIRAMOTO '95/6/12		TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y (DYED COLOR)	
APP'D BY M.FUKUSHIMA '95/6/12		DR. DATE		REV B	
角度 ANGLE ±3°		REVIS ONLY ON CAD SYSTEM			
30以上 OVER	±0.3	B	変更 REVIS (U50425)	Y.M. H.H.	'95/6/12
10以上 30未滿 UNDER	±0.25	A	変更及び再作成 REVIS & REDRAWN (J20435)	M.H. H.H.I.	'92/5/27
10未滿 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVIS RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES					